

证券代码： 600584

证券简称：长电科技

**江苏长电科技股份有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研                      <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访                              <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会                          <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称 （排名不分先后）</p>	<p>中国人寿、平安资产、中国太平洋保险、中国人保、泰康资产、易方达基金、华夏基金、南方基金、嘉实基金、博时基金、富国基金、汇添富基金、国泰基金、高毅资产、淡水泉、平安养老、太平资产、中欧基金、兴证全球基金、永赢基金、华商基金、国新投资、华泰资产、长江养老、摩根基金、汇丰晋信基金、华安基金、鹏扬基金、万家基金、诺安基金、财通基金、西部利得基金、长信基金、中银基金、浦银安盛基金、申万菱信基金、国金基金、中海基金、国投瑞银基金、宏利基金、华泰保兴基金、泰康基金、兴银基金、宝盈基金、东吴基金、德邦基金、惠升基金、恒越基金、汇泉基金、中信保诚、百年保险、中原农业保险、信泰人寿、国华兴益、诚旻投资、CPE 源峰、天弘基金、泓德基金、复胜资产、敦和资产、运舟资本、远信投资、同犇投资、彩石资本、丹羿投资、道仁资产、浩成资产、静远投资、立格资本、磊亚投资、长心投资、同创金鼎投资、咏明资产、睿谷投资、循远资产、上海天猗投资、锐方基金、恒昇私募、新湖财富投资、中才中环基金、姚泾河基金、北京禧悦、粒子跃动私募基金、HVC 投资、九方云智能科技</p> <p>Citadel International、Point72 Asset Management、T. Rowe Price、Franklin Templeton Investments、Invesco、Goldman Sachs Asset Management、GIC Private Ltd、Harvard University Management、Hillhouse Capital、Baillie Gifford、Balyasny Asset Management、Farallon Capital Management、Schonfeld Strategic Advisors、</p>

	<p>Wellington Management、AllianceBernstein、ICICI Prudential Asset Management、Cathay Life Insurance、Putnam Investments、Candriam、Dymon Asia Capital、Pinpoint Asset Management、Spring Capital、Janchor Partners、Taikang Asset Management、Washington University Investment Management、Cephei Capital、Fenghe Asset Management、Hao Capital Management、Matthews International Capital Management、Sands Capital Management、Select Equity Group、BNP Paribas、Desjardins Global Asset Management、Symmetry Investments、Wexford Capital、Hel Ved Capital、Broad Peak Capital、Carrhae Capital、C World Wide Asset Management、East Capital Asia、Highclere International Investors、Neo-criterion Capital、Opendoor Capital、Ovata Capital Management、Polen Capital、Tekne Capital Management、Torito Capital Limited、TT International、Valliance Asset Management、WFM Asia、FengYing Research &amp; Investment、Grand Alliance Asset Management、Zhong Yong Capital、Yi Piao Capital、Symphony Asset Management、JD Asset Management、Owada Fund Management</p> <p>瑞银证券、花旗证券、伯恩斯坦证券、麦格理集团、中信里昂证券、中泰证券、长江证券、华创证券、财通证券、天风证券、华福证券、兴业证券、申万宏源、平安证券、开源证券、华泰证券、东北证券等</p>
时间	2026年1月9日-3月26日
地点	上海
上市公司接待人员	<p>公司副总裁：吴宏鲲先生</p> <p>投资者关系团队</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题一：公司对今年下游应用的市场走势是如何判断的？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好。整个半导体市场仍在延续上行趋势。从技术应用来看，行业正处于承前启后、辞旧迎新的关键阶段。工业和汽车电子领域虽有此起彼伏的波动，但总体保持持续复苏态势。移动终端持续智能化，也进一步拉动了高端产品需求。人工智能生态的持续壮大，带动的不仅是算力芯片，更是整个人工智能生态链各环节的协同发展，运算电子整体需求呈现明显增长</p>

趋势。

在此过程中，我们仍需做好传统业务的取舍与产品结构的优化，集中力量在先进封装领域，对新技术、新产能进行前瞻性布局。从去年四季度趋势来看，市场将继续保持稳中向上的势头，这一发展方向将继续延伸至 2026 年。我们将坚定产品结构优化的核心方向，牢牢把握先进技术发展趋势。感谢您的关注与支持！

**问题二：公司下一步的扩产规划及资本开支计划？**

答：关于下一步扩产规划，公司将基于对市场的研判继续聚焦高端产能布局并围绕以下几方面展开：一是应用领域倾斜，结合未来市场预判，保持向汽车电子、运算存储、高密度电源等领域适度侧重；二是深化客户合作，始终重视客户关系，持续加强与头部高端客户的绑定；三是加大研发投入，聚焦先进封装技术及前沿领域的突破，推动技术发展与应用需求深度契合。总体来看，结合当前先进封装的旺盛需求趋势，公司将持续加大相关投资力度。2026 年资本开支计划具体规划将在后续完成相关审批后进行披露。

**问题三：公司对 2026 年国内及海外客户的需求展望？**

尊敬的投资者，您好。从国内外两个市场来看，受当前国际形势新变化影响，确实呈现出不同的发展态势。

国内市场方面，面向中国本土需求的芯片需求正持续增长。无论是海外客户“在中国，为中国”的需求趋势，还是中国本土集成电路企业的需求，都展现出强劲的发展势头，这一趋势十分明显，也带动了我国集成电路产业的进一步发展。

海外市场方面，受关税等因素影响，确实存在一定波动。但从大趋势来看，海外市场在人工智能的驱动下，正带动整个生态链持续向前发展。对我们而言，核心是在各类因素交织的背景下，坚持优化产品结构。借着产业市场变化的契机，加快推进与核心

客户合作的、具有发展潜力的未来产品落地。与此同时，在当前市场环境下，也是调整和取舍产品结构的良好时机，对于同质化强、易在海外市场陷入内卷的产品，逐步收缩布局。这样才能在行业逐步沉淀、形成稳固发展格局时，做好充分准备。感谢您的关注与支持！

**问题四：请介绍一下公司在存储业务的布局情况，晟碟半导体的经营情况？**

答：尊敬的投资者，您好。整个晟碟工厂的经营状态，正健康良性地发展。并购 80% 股权后，我们与外方股东共同持续加大对工厂的投入，聚焦新产品的技术更新与产能扩张。

存储产品市场存在一定波动性，具有典型的周期性特征。但叠加当前人工智能在数据中心与端侧的新增需求后，整个存储类产品目前呈现需求大于供给的状态，且这一格局预计在未来一段时间内仍将延续。后续我们将依托晟碟以及长电科技多工厂布局的存储类产品业务，进一步提升企业级 SSD 的市场份额，尤其聚焦高密度存储类产品的发展。目前这一规划已在各工厂间形成协同赋能，相信能为业界对存储产品，特别是先进高密度存储产品的需求提供有力贡献。感谢您的关注与支持！

**问题五：公司在先进封装方面的布局进展如何？**

答：尊敬的投资者，您好。随着中国以数据中心为核心的智算市场持续发展，越来越多企业开始开发面向本土的定制化方案。当前不仅是算力芯片的迭代升级，其带动的生态，包括存力、电力等对技术的要求也在提升。定制化需求不断细化和提高，将直接催生未来几年国内市场对先进封装及整个产业链的强劲需求。长电科技依托深厚的技术积累与丰富的量产经验，与国际领先企业保持技术同步发展。公司持续加大先进封装领域的投入，全面覆盖主流技术路线，通过不断优化技术布局与工艺，已构建多层次的封装与测试能力，可满足多个应用领域的需求。公司正

持续推动长电微电子晶圆级微系统集成高端制造项目的产品上量，并按照客户要求加快进行产能扩充。

**问题六：公司位于上海临港的新工厂已正式启用，能否对这个新工厂聚焦的车规级与机器人芯片前景做个展望？**

答：尊敬的投资者，您好。作为长电科技在汽车电子领域的重要战略布局，长电科技汽车电子（上海）有限公司围绕智能驾驶、车身与底盘控制、动力与能源管理等核心应用方向，系统构建高可靠、高一致性的车规级芯片成品制造能力。该工厂的正式投产，标志着我国大陆在高标准、高性能汽车芯片封测领域迈上新台阶。

智能汽车与智能机器人在芯片和系统层面的底层逻辑高度契合，两者本质上都是“在物理世界中运行的智能体”，相关芯片在算力、集成度和应用方面呈现出高度共性。基于这一产业趋势，公司在夯实车规级封测能力的同时，打造出无缝承载机器人控制、感知等芯片封测需求的技术能力。

此外，公司全面引入智能制造理念，通过智能产线、自动化物流与全流程可追溯系统，实现制造过程的精细化管理；同时引入人工智能技术进行生产监控、质量分析和缺陷识别，持续提升良率水平和运营效率。

**问题七：请问公司如何看待当前手机及消费电子需求下滑对业务的潜在影响？**

答：公司已在去年先于半导体行业推动业务结构调整及针对传统通讯业务的取舍，通讯及消费电子收入占比已较历史周期显著收敛，且内部结构主要面向当前需求韧性较强的高端市场。与此同时，运算、工业及汽车业务在 2025 年前三季度保持快速增长，收入占比已接近 40%，叠加国际客户针对中国市场的产能布局需求旺盛，这些因素共同构成了公司业绩的坚实支撑。目前公司已经形成多元化收入支撑，单一领域的市场波动对公司整体的

	<p>边际影响已明显小于以往周期。</p> <p><b>问题八：请介绍公司面向 CPO(光电合封)技术方面的布局？</b></p> <p>答：作为全球领先的集成电路成品制造与技术服务提供商，长电科技在 CPO 领域积极布局，已与多家客户开展合作，提供全面的 CPO 解决方案与配套产能。长电科技采用 XDFOI®先进封装工艺的光引擎产品，于近期完成客户样品交付并在客户端通过测试。该架构通过在封装体内实现光电器件与逻辑芯片的高密度集成，在封装层面有效优化了能效与带宽表现，为降低系统互连损耗和提升整体可扩展性提供了支持。</p> <p>未来，CPO 技术产品的进一步突破与规模化应用仍有赖于产业链各环节的持续协同创新。长电科技将持续加大在先进封装领域的投入，重点布局多维异质异构微系统集成与光测试等关键能力建设，为高性能计算、数据中心及下一代网络系统提供先进、可靠的集成电路器件成品制造技术和服务。</p>
附件清单(如有)	无